

大電流対応厚銅基板

Heavy Copper PWB

特長 Features

- 大電流ユニットに対応
Correspondence to Large Current unit
- 銅厚: 175 μ m~500 μ m
Copper Thickness: 175 μ m~500 μ m
※内層210 μ m以上(開発中)

用途 Application

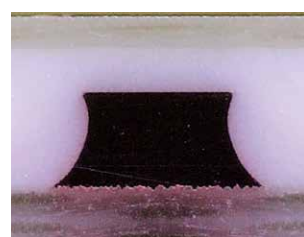
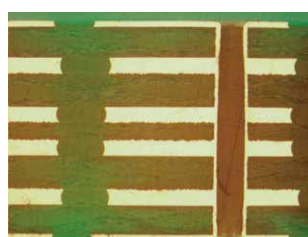
- ジャンクションボックス
- 電源モジュール
- 充電器
- インバーター/コンバーター/トランス

基板仕様 PWB Specification

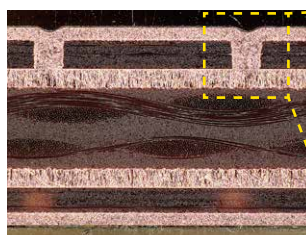
基板仕様	内層導体厚	層構成	板厚	最小導体幅	最小導体間隔	層間厚
厚銅貫通	量産中 175 μ m	~6層	~3.0mm	400 μ m	400 μ m	300~350 μ m
	R&D 210 μ m	~6層	~3.0mm	450 μ m	450 μ m	300~350 μ m
	R&D 300 μ m	~6層	~3.0mm	600 μ m	600 μ m	350~450 μ m
	R&D 500 μ m	~6層	~3.0mm	1000 μ m	1000 μ m	350~450 μ m
基板仕様	内層導体厚	層構成	板厚	LVH径	めっき厚	層間厚
厚銅ビルド	R&D 105 μ m	~6層	~3.0mm	150 μ m	60 μ m	110 μ m



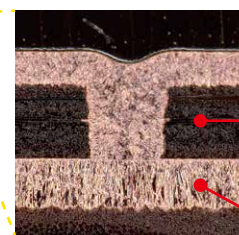
量産中 充電設備/6層貫通 内層175 μ m
 広州工場にて6層貫通基板(内層175 μ m)の量産実績あり



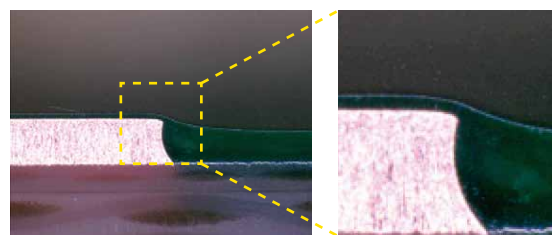
R&D 内層210 μ m以上
 絶縁層形成に樹脂シートを使用することで、
 絶縁信頼性向上、薄板化、軽量化が可能。



R&D 厚銅ビルド基板 内層105 μ m
 厚銅回路の高密度化。
 制御系と電源系の基板一体化が可能。



絶縁層:
110 μ m
 内層導体厚
105 μ m



R&D 外層超厚銅(210 μ m以上)対応
 外層厚銅(210 μ m)対応したSR塗布工法により
 大電流化が可能。